

SEMI G72.2-0997

ボールグリッドアレイ設計ライブラリのための設計提案: 388 ピンプラスチックボールグリッドアレイ

免責事項:この SEMI スタンドアードは、投票により作成された英語版が正式なものであり、日本語版は日本の利用者各位の便宜のために作成したものです。万が一英語と日本語とに差異がある場合には英語版記載内容が優先されます。

表 1 プラスチックボールグリッドアレイ (PBGA) 一般設計特性

ボール 計数	信号 I/O	本体寸法	ピッチ	マトリックス	アレイ	熱強調	プロファイル 高さ	キャビティ 方向	ワイヤボン ド リング
388	304	35×35	1.27	26×26	まばら	6×6	2.33	上	2

基板材料	金属層	ダイ相互 接続	パッケージング 設計/材料		ボール 組成	JEDEC 分類記号	予調整 レベル	設計番号	SEMI 分類記号 番号
BT 積層	2(2S0P0G)	ワイヤ ボン ド	オーバー モールド	エポキシ	63/37 Sn/Pb	MO-151 BAR-2, B	レベル 3, 改訂 0	PBD0002	G72.2

表 2 388 ピンプラスチックボールグリッドアレイ 35×35 mm 本体設計

Design No. PBD0002	SEMI Standard BGA Design Library			Revision Initial	Date 10/22/96	Page 2 of 10
PBGA Wire Bond Pad (*1)	Solder Ball Location	Die Wire Bond Pad (*3)	I/O Name (& Comments) (*4)		Pkg. Side (*1)	Notes
w/b ring 1	A1					3
w/b ring 1	A2					3
304	A3				4	
300	A4				4	
296	A5				4	
293	A6				4	
289	A7				4	
285	A8				4	
283	A9				4	
279	A10				4	
275	A11				4	
272	A12				4	
268	A13				4	
264	A14				4	
260	A15				4	
258	A16				4	
254	A17				4	
251	A18				4	
248	A19				4	
244	A20				4	
242	A21				4	
238	A22				4	
234	A23				4	
231	A24				4	
229	A25				4	
w/b ring 1	A26					3
1	B1				1	
w/b ring 1	B2					3
302	B3				4	
298	B4				4	
295	B5				4	
291	B6				4	
287	B7				4	
284	B8				4	
281	B9				4	
277	B10				4	

Design No. PBD0002	SEMI Standard BGA Design Library			Revision Initial	Date 10/22/96	Page 2 of 10
PBGA Wire Bond Pad (*1)	Solder Ball Location	Die Wire Bond Pad (*3)	I/O Name (& Comments) (*4)		Pkg. Side (*1)	Notes
273	B11				4	
270	B12				4	
266	B13				4	
262	B14				4	
259	B15				4	
256	B16				4	
252	B17				4	
250	B18				4	
246	B19				4	
243	B20				4	
239	B21				4	
235	B22				4	
232	B23				4	
230	B24				4	
w/b ring 1	B25					3
w/b ring 1	B26					3
3	C1				1	
2	C2				1	
w/b ring 1	C3					3
303	C4				4	
301	C5				4	
297	C6				4	
294	C7				4	
290	C8				4	
286	C9				4	
282	C10				4	
278	C11				4	
274	C12				4	
271	C13				4	
269	C14				4	
265	C15				4	
261	C16				4	
257	C17				4	
253	C18				4	
249	C19				4	
245	C20				4	
241	C21				4	
237	C22				4	

Design No. PBD0002	SEMI Standard BGA Design Library			Revision Initial	Date 10/22/96	Page 2 of 10
PBGA Wire Bond Pad (*1)	Solder Ball Location	Die Wire Bond Pad (*3)	I/O Name (& Comments) (*4)		Pkg. Side (*1)	Notes
233	C23				4	
w/b ring 1	C24					3
226	C25				3	
228	C26				3	
6	D1				1	
4	D2				1	
5	D3				1	
w/b ring 1	D4					3
299	D5				4	
w/b ring 2	D6					2
292	D7				4	
288	D8				4	
w/b ring 1	D9					3
280	D10				4	
w/b ring 2	D11					2
276	D12				4	
267	D13				4	
w/b ring 1	D14					3
263	D15				4	
w/b ring 2	D16					2
255	D17				4	
247	D18				4	
w/b ring 1	D19					3
240	D20				4	
w/b ring 2	D21					2
236	D22				4	
w/b ring 1	D23					3
227	D24				3	
222	D25				3	
224	D26				3	
10	E1				1	
7	E2				1	
9	E3				1	
8	E4				1	
223	E23				3	
225	E24				3	
219	E25				3	
220	E26				3	